

2024-2030年中国芯片市场 深度分析与投资前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国芯片市场深度分析与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/416481.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

芯片（半导体元件产品的统称），集成电路，缩写作 IC；或称微电路、微芯片、晶片/芯片在电子学中是一种将电路（主要包括半导体设备，也包括被动组件等）小型化的方式，并时常制造在半导体晶圆表面上。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片市场深度分析与投资前景报告》共十三章。首先介绍了芯片行业市场发展环境、芯片整体运行态势等，接着分析了芯片行业市场运行的现状，然后介绍了芯片市场竞争格局。随后，报告对芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对芯片产业有个系统的了解或者想投资芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章芯片行业的总体概述

1.1 基本概念

1.2 制作过程

1.2.1 原料晶圆

1.2.2 晶圆涂膜

1.2.3 光刻显影

1.2.4 掺杂杂质

1.2.5 晶圆测试

1.2.6 芯片封装

1.2.7 测试包装

第二章 2017-2022年全球芯片产业发展分析

2.1 2017-2022年世界芯片市场综述

2.1.1 市场特点分析

2.1.2 全球市场规模

2.1.3 市场竞争格局

2.2 2017-2022年美国芯片产业分析

- 2.2.1 市场发展格局
- 2.2.2 行业并购情况
- 2.2.3 类脑芯片发展
- 2.2.4 技术研发动态
- 2.3 2017-2022年日本芯片产业分析
 - 2.3.1 产业订单规模
 - 2.3.2 技术研发进展
 - 2.3.3 芯片工厂布局
 - 2.3.4 日本产业模式
 - 2.3.5 产业投资动态
- 2.4 2017-2022年韩国芯片产业分析
 - 2.4.1 产业发展阶段
 - 2.4.2 市场格局分析
 - 2.4.3 市场发展规模
 - 2.4.4 市场发展战略
- 2.5 2017-2022年印度芯片产业分析
 - 2.5.1 芯片设计发展形势
 - 2.5.2 产业发展困境分析
 - 2.5.3 产业发展对策分析
 - 2.5.4 未来发展机遇分析
- 2.6 其他国家芯片产业发展分析
 - 2.6.1 英国
 - 2.6.2 德国

第三章 2017-2022年中国芯片产业发展环境分析

- 3.1 政策环境分析
 - 3.1.1 智能制造政策
 - 3.1.2 集成电路政策
 - 3.1.3 智能传感器政策
 - 3.1.4 “互联网+”政策
- 3.2 经济环境分析
 - 3.2.1 国民经济运行状况

3.2.2 工业经济增长情况

3.2.3 固定资产投资情况

3.2.4 经济转型升级形势

3.2.5 宏观经济发展趋势

3.3 社会环境分析

3.3.1 互联网加速发展

3.3.2 智能芯片不断发展

3.3.3 科技人才队伍壮大

3.3.4 万物互联带来需求

3.4 技术环境分析

3.4.1 技术研发进展

3.4.2 无线芯片技术

3.4.3 技术发展方向

第四章 2017-2022年年中国芯片所属产业发展分析

4.1 2017-2022年中国芯片产业发展状况

4.1.1 产业发展背景

4.1.2 产业发展意义

4.1.3 产业发展成就

4.1.4 产业发展规模

4.1.5 产业加速发展

4.1.6 产业发展契机

4.2 2017-2022年中国芯片市场格局分析

4.2.1 厂商经营现状

4.2.2 区域布局状况

4.2.3 市场发展形势

4.3 2017-2022年中国量子芯片发展进程

4.3.1 产品发展历程

4.3.2 市场发展形势

4.3.3 产品研发动态

4.3.4 未来发展前景

4.4 2017-2022年芯片产业区域发展动态

- 4.4.1 湖南
- 4.4.2 上海
- 4.4.3 北京
- 4.4.4 深圳
- 4.4.5 晋江
- 4.4.6 西安
- 4.5 中国芯片产业发展困境分析
 - 4.5.1 市场垄断困境
 - 4.5.2 过度依赖进口
 - 4.5.3 技术短板问题
- 4.6 中国芯片产业应对策略分析
 - 4.6.1 突破垄断策略
 - 4.6.2 产业发展对策
 - 4.6.3 加强技术研发

第五章 2017-2022年中国芯片产业上游市场发展分析

- 5.1 2017-2022年中国半导体产业发展分析
 - 5.1.1 产业链结构
 - 5.1.2 行业发展意义
 - 5.1.3 产业发展基础
 - 5.1.4 产业发展态势
 - 5.1.5 产业规模现状
 - 5.1.6 产业投资基金
- 5.2 2017-2022年中国芯片设计行业发展分析
 - 5.2.1 产业发展历程
 - 5.2.2 市场发展现状
 - 5.2.3 市场销售规模
 - 5.2.4 产业区域分布
- 5.3 2017-2022年中国晶圆代工产业发展分析
 - 5.3.1 晶圆加工技术
 - 5.3.2 晶圆制造工艺
 - 5.3.3 晶圆工厂分布

5.3.4 企业竞争现状

5.3.5 行业发展展望

第六章 芯片行业重点企业经营分析

6.1 高通（Qualcomm）

6.1.1 企业发展简况分析

6.1.2 企业经营情况分析

6.1.3 企业经营优劣势分析

6.2 博通有限公司

6.2.1 企业发展简况分析

6.2.2 企业经营情况分析

6.2.3 企业经营优劣势分析

6.3 英伟达（NVIDIA Corporation）

6.3.1 企业发展简况分析

6.3.2 企业经营情况分析

6.3.3 企业经营优劣势分析

6.4 美国超微公司（AMD）

6.4.1 企业发展简况分析

6.4.2 企业经营情况分析

6.4.3 企业经营优劣势分析

6.5 Marvell

6.5.1 企业发展简况分析

6.5.2 企业经营情况分析

6.5.3 企业经营优劣势分析

6.6 赛灵思（Xilinx）

6.6.1 企业发展简况分析

6.6.2 企业经营情况分析

6.6.3 企业经营优劣势分析

6.7 Cirrus logic

6.7.1 企业发展简况分析

6.7.2 企业经营情况分析

6.7.3 企业经营优劣势分析

6.8 联发科

6.8.1 企业发展简况分析

6.8.2 企业经营情况分析

6.8.3 企业经营优劣势分析

6.9 展讯

6.9.1 企业发展简况分析

6.9.2 企业经营情况分析

6.9.3 企业经营优劣势分析

6.10 其他企业

6.10.1 海思

6.10.2 瑞星

6.10.3 Dialog

第七章 晶圆代工行业重点企业经营分析

7.1 格罗方德

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 经营状况

7.2 三星（ Samsung ）

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 经营状况

7.3 Tower jazz

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 经营状况

7.4 富士通

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 经营状况

7.5 台积电

7.5.1 企业发展概况

7.5.2 经营状况

7.6 联电

7.6.1 企业发展概况

7.6.2 经营状况

7.7 力晶

7.7.1 企业发展概况

7.7.2 经营状况

7.8 中芯

7.8.1 企业发展概况

7.8.2 经营状况

7.9 华虹

7.9.1 企业发展概况

7.9.2 经营状况

第八章 2017-2022年中国芯片产业中游市场发展分析

8.1 2017-2022年中国芯片封装行业发展分析

8.1.1 封装技术介绍

8.1.2 市场发展现状

8.1.3 国内竞争格局

8.1.4 技术发展趋势

8.2 2017-2022年中国芯片测试行业发展分析

8.2.1 芯片测试原理

8.2.2 测试准备规划

8.2.3 主要测试分类

8.2.4 发展面临的问题

8.3 中国芯片封测行业发展方向分析

8.3.1 行业发展机遇

8.3.2 集中度持续提升

8.3.3 产业竞争加剧

8.3.4 产业短板补齐升级

第九章 芯片封装测试行业重点企业经营分析

9.1 Amkor

9.1.1 企业发展概况

9.1.2 经营状况

9.2 日月光

9.2.1 企业发展概况

9.2.2 经营状况

9.3 矽品

9.3.1 企业发展概况

9.3.2 经营状况

9.4 南茂

9.4.1 企业发展概况

9.4.2 经营状况

9.5 长电科技

9.5.1 企业发展概况

9.5.2 经营状况

9.6 天水华天

9.6.1 企业发展概况

9.6.2 经营状况

9.7 通富微电

9.7.1 企业发展概况

9.7.2 经营状况

9.8 士兰微

9.8.1 企业发展概况

9.8.2 经营状况

9.9 其他企业

9.9.1 颀邦

9.9.2 UTAC

9.9.3 J-Device

第十章 2017-2022年中国芯片产业下游应用市场发展分析

10.1 LED

10.1.1 芯片产值规模

10.1.2 企业发展动态

10.1.3 封装技术难点

10.1.4 行业规模预测

10.1.5 LED产业趋势

10.2 物联网

10.2.1 产业链的地位

10.2.2 市场发展状况

10.2.3 细分市场规模

10.2.4 物联网wifi芯片

10.2.5 国产化的困境

10.2.6 产业发展困境

10.3 无人机

10.3.1 无人机产业链

10.3.2 中国市场规模

10.3.3 市场竞争格局

10.3.4 主流主控芯片

10.3.5 芯片应用领域

10.3.6 市场前景趋势

10.4 北斗系统

10.4.1 北斗芯片概述

10.4.2 产业发展态势

10.4.3 芯片产销状况

10.4.4 芯片研发进展

10.4.5 资本助力发展

10.4.6 产业发展趋势

10.5 智能穿戴

10.5.1 行业发展规模

10.5.2 市场竞争格局

10.5.3 核心应用芯片

10.5.4 芯片厂商对比

10.5.5 行业发展方向

10.5.6 商业模式探索

10.6 智能手机

10.6.1 市场发展状况

10.6.2 手机芯片销量

10.6.3 无线充电芯片

- 10.6.4 市场竞争格局
- 10.6.5 产品性能情况
- 10.7 汽车电子
 - 10.7.1 行业发展状况
 - 10.7.2 芯片制造标准
 - 10.7.3 车用芯片市场
 - 10.7.4 车用芯片格局
 - 10.7.5 汽车电子渗透率
 - 10.7.6 未来发展前景
- 10.8 生物医药
 - 10.8.1 基因芯片介绍
 - 10.8.2 主要技术流程
 - 10.8.3 技术应用情况
 - 10.8.4 重点企业分析
 - 10.8.5 生物研究的应用
 - 10.8.6 发展问题及前景

第十一章 2017-2022年中国集成电路产业发展分析

- 11.1 2017-2022年集成电路市场规模分析
 - 11.1.1 全球市场规模
 - 11.1.2 全球收入规模
 - 11.1.3 中国销售规模
 - 11.1.4 中国进口规模
 - 11.1.5 中国出口规模
- 11.2 2017-2022年中国集成电路市场竞争格局
 - 11.2.1 进入壁垒提高
 - 11.2.2 上游垄断加剧
 - 11.2.3 内部竞争激烈
- 11.3 提升集成电路产业核心竞争力方法
 - 11.3.1 提高扶持资金集中运用率
 - 11.3.2 制定融资投资制度
 - 11.3.3 提高政府采购力度

- 11.3.4 建立技术中介服务制度
- 11.3.5 人才引进与人才培养
- 11.4 中国集成电路产业发展的问题及对策
 - 11.4.1 产业发展问题
 - 11.4.2 产业发展策略
 - 11.4.3 “十三五”发展建议
- 11.5 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析
 - 11.5.1 全球市场趋势
 - 11.5.2 国内行业趋势
 - 11.5.3 行业机遇分析
 - 11.5.4 行业发展预测

第十二章 2024-2030年中国芯片行业投资分析()

- 12.1 投资机遇及方向分析
 - 12.1.1 投资价值较高
 - 12.1.2 战略资金支持
 - 12.1.3 投资需求上升
 - 12.1.4 投资大周期开启
 - 12.1.5 大基金投资方向
- 12.2 行业投资分析
 - 12.2.1 投资研发加快
 - 12.2.2 融资动态分析
 - 12.2.3 阶段投资逻辑
 - 12.2.4 国有资本为重
- 12.3 行业并购分析
 - 12.3.1 全球产业并购规模
 - 12.3.2 全球产业并购动态
 - 12.3.3 国内并购动态分析
- 12.4 投资风险分析
 - 12.4.1 贸易政策风险
 - 12.4.2 贸易合作风险
 - 12.4.3 宏观经济风险

- 12.4.4 技术研发风险
- 12.4.5 环保相关风险
- 12.4.6 产业结构性风险
- 12.5 融资策略分析
- 12.5.1 项目包装融资
- 12.5.2 高新技术融资
- 12.5.3 BOT项目融资
- 12.5.4 IFC国际融资
- 12.5.5 专项资金融资

第十三章 中国芯片产业未来前景展望()

- 13.1 中国芯片市场发展机遇分析
- 13.1.1 中国产业发展机遇分析
- 13.1.2 国内市场变动带来机遇
- 13.1.3 芯片产业未来发展趋势
- 13.2 中国芯片产业细分领域前景展望
- 13.2.1 芯片材料
- 13.2.2 芯片设计
- 13.2.3 芯片制造
- 13.2.4 芯片封测

部分

图表目录：

图表：日本综合电机企业的半导体业务重组

图表：东芝公司半导体事业改革框架

图表：智能制造系统架构

图表：智能制造系统层级

图表：MES制造执行与反馈流程

图表：云平台体系架构

图表：《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标

图表：《中国集成电路产业“十三五”发展规划建议》发展目标

图表：2017-2022年国内生产总值及其增长速度

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/416481.html>